



HP ProLiant BL465c G6刀片服务器



HP ProLiant BL465c G6具有可靠的性能和可扩展性，支持业界领先的管理工具，并采用针对密集型计算环境的各种最新技术。

惠普刀片服务器功能强大、性能可靠，具有与屡获殊荣的惠普机架服务器和塔式服务器同样卓越的功能。双处理器BL465c G6具有与标准1U机架服务器相同的功能，并集成了节能型计算功能与高密度性、扩展内存以及I/O，可显著提高系统性能。此款均衡架构带有六核AMD Opteron™（皓龙™）处理器、DDR2内存、串行硬盘、多功能千兆网络支持和多I/O卡，可为您提供一个适合多种应用的高性能系统。同时，该外形小巧的BL465c G6还具有确保系统高可用性的各项功能，如热插拔硬盘、内存交错、嵌入式RAID功能，以及增强的远程Lights-Out管理等。

所有企业都面临如下挑战

成本日益增加：IT部门的工作目标无一例外，都是尽可能以最低成本为企业提供可靠的IT服务。但是，传统IT基础设施的运行成本在IT总体成本中所占比例相当高，难以有效降低计算成本。

不断的变更：如果要对典型的数据中心进行变更，存在的一个最大障碍便是：需要在多个团队间进行人工协调，以实现内部流程的同步。IT基础设施的硬接线和静态设计要求人工完成，需要一对一的IT实务操作。最终，进程速度决定于必须参与其中的人员数目。如果需要多人在三天时间进行计划和实施，30分钟即可做完的工作根本不可能在30分钟之内完成。

电源和散热需求日益增长：数据中心的电费激增，一台服务器三年的电力成本甚至即将超出其购置成本。与此同时，服务器更加密集、散热量更大，将耗费更多电力，并需要更多空调进行散热。目前，由于许多数据中心的电源和散热资源十分有限，扩展能力受到极大限制，几乎难以满足企业需求。

各流程十分耗时：一般的数据中心都存在宕机故障、效率十分低下，每周要白白浪费掉数百万美元的资金。设备与管理员二者要达到更佳比例，必须对每个步骤、任务和流程进行简化，从而实现效率大幅提升和灵活性的显著提高。



**四核皓龙™
处理器**

为有效减少传统IT基础设施的种种限制，HP BladeSystem提供了性能卓越的IT基础设施，具有“开箱即用”特性，——将服务器、存储、网络、电源/散热和各项管理功能进行完美整合，从而真正赋予企业以无限可能的发展潜力。



简易性、灵活性与卓越价值

降低成本：与传统IT相比，其整合设计模式令购置价格更为经济，同时效率也获得提升。此款服务器可有效降低IT成本及复杂性，能够实现各种资源的通力合作，并轻松实施变更。

随时进行变更：HP虚拟连接技术可消除进行变更的诸多障碍，令您能够实时地应对业务需求，获得无与伦比的竞争优势。

节能特性：HP能量智控技术通过对电源和散热进行管理，可实现效率的显著提升。

省时：HP洞察管理技术对预先配置的自动化基础设施进行管理，能够节省大量宝贵时间。

特性与优势

大幅提升性能

- 采用AMD Dual Dynamic Power Management™技术的2个AMD Opteron™ (皓龙™)2400系列六核处理器，可提高现有x86/64虚拟化解决方案的性能
- 支持高达64 GB的ECC寄存式DDR2 DIMM内存和内存交错功能
- 具有2个中间件I/O扩展插槽，可实现多样性配置
- HP Smart Array E200i存储控制器配有64 MB读缓存，并可选配电池支持的高速缓存，能够显著提升磁盘性能和可靠性

简化部署与生命周期管理

- 由iLO 2提供支持的ProLiant板载管理器(Onboard Administrator)，可提供业界领先的远程控制和嵌入式健康管理功能，包括虚拟KVM和图示远程控制台
- 通过HP iLO Power Management软件包，可对服务器能耗和散热进行集中控制，实现可靠的安全性，同时节省大量能源
- 借助HP Power Regulator，可有效掌控能耗与系统性能
- 通过易于安装的软件套件HP Insight Control，可实现系统全面正常运行、远程控制、漏洞扫描和补丁管理以及灵活的部署与电源管理

为用户提供各种选件，实现更大灵活性

- 低功率处理器选件：旨在提升单位密度性能与每瓦性能，为用户有效改善系统的散热性能，并实现功耗最优化。
- 可防止数据丢失的本地存储选件，包括外形小巧的高性能热插拔串行硬盘驱动和电池支持的写缓存选件
- 借助可选配的光纤通道、iSCSI、以太网、InfiniBand和SAS中间件卡，进行I/O扩展
- 通过直连的存储刀片服务器和刀片扩展模块，获得额外的本地存储、数据保护或PCI卡扩展



**四核皓龙™
处理器**

HP服务

当技术产生效用时，业务也随之更好的运转

HP技术服务 (Technology Service) 可提供一系列综合的HP Care Pack Service服务，利用易于购买、易于使用的技术支持软件包来帮助设计、部署、管理以及支持IT环境。

最低推荐HP Care Pack服务

- 三年工作日当天4小时内响应，24小时全天候现场服务、硬件技术支持。
- 硬件安装、操作系统安装与启动增强级Care Pack服务
- 三年技术支持、24小时：综合性全天24小时硬件软件操作支持
- 主动选择：享受HP顶级技术顾问服务。购买服务并在需要时获得专家指导。

HP Care Pack服务可帮你：

- 缩短部署时间、流畅、高效地管理ProLiant服务器解决方案。
- 延长系统正常运行时间、为你的企业提升可用服务器性能。
- 快速检测、诊断以及修理故障，节省时间、资金以及资源。

如需了解更多信息敬请访问：

www.hp.com/services/proliantservices或

www.hp.com/go/proliant/carepack

HP ProLiant BL465c G6刀片服务器



四核皓龙™
处理器

技术参数 HP ProLiant BL465c G6 刀片服务器



处理器和内存	
处理器数	1 至 2 个处理器
最大核数	12
支持的处理器	六核AMD Opteron™ (皓龙™) 处理器: 型号 2435 (2.6 GHz) 型号 2427 (2.2 GHz)
是否提供低功率处理器	是
高速缓存	每核心 512 KB 二级高速缓存; 6 MB 三级高速缓存
HyperTransport最高速度	2.2 GHz
内存类型	PC2-6400 寄存式 DDR2 800 MHz PC2-5300 寄存式 DDR2 667 MHz
标配内存	4 GB
最大内存	64 GB
高级内存保护	高级 ECC
存储	
存储类型	热插拔 SFF SAS 热插拔 SFF SATA
最大内置存储	最多2个: 热插拔 SFF SAS 15K 146/72/36 GB 或 10K 300/146/72/36 GB; 热插拔 SFF SATA 5.4K 120/250 GB
最多内置驱动器机架数	2
扩展槽	2
存储控制器	智能阵列 E200i 控制器
部署	
外形	刀片式
机架高度	Blade System c700机箱支持16个刀片或Blade System c3000机箱支持8个刀片
网络接口	2 个嵌入式 NC370i 多功能千兆以太网服务器适配器 1 个专用于 iLO 2 管理的附加 10/100 服务器适配器
远程管理	由 iLO 2 提供支持的 ProLiant 板载管理器 (Onboard Administrator)
冗余电源	3+3电源冗余
保修	3 年部件/3 年人工/3 年现场, 免费首次有限安装服务

如需了解其它技术参数, 敬请访问: http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/13348_div/13348_div.pdf

针对密集型计算环境的最新技术

- 对64位系统实施更为密集的部署，不会损失任何功能
- 支持多达8个寄存式DDR2 DIMM内存扩展插槽，可有效减少系统瓶颈
- 多达2个小巧外形的热插拔串行硬盘
- 具有2个扩展插槽，同时支持多个I/O卡

HP相对于其它刀片解决的优势

我们的独特创新可真正帮您解决最大的难题。惠普 (HP) 自始至终采用其一流的技术，将这些先进技术融入到刀片服务器中，使其易于使用，并为您带来卓越价值。

- 能量智控技术：通过采用先进技术，电力消耗可降低 30%，您每时每刻都在降低能耗并减轻空调负荷。
- 虚拟连接架构：一次布线，然后在运行中即可对刀片服务器进行添加、更换或恢复，而不会影响到网络和存储，也无需额外步骤。
- 洞察管理技术：简单的单个软件包提供了简化操作的所有工具，可将管理员的工作效率提升十倍。

- 无需中断的高可用性背板：具有与保证华尔街正常运营同样的可靠性，确保您的业务正常运行。
- 板载管理器 (Onboard Administrator)：其向导有助于快速启动和正常运行，并提供可简化日常工作的有用工具，并针对潜在问题发出警告，同时还可帮助您进行修复。

以最轻松的方式进行 IT 投资

HP 金融服务 (Financial Services) 为您提供了创新的理财和金融资产计划，可协助企业在对 HP 解决方案进行购置、管理乃至最终处理时显著降低成本。如需了解更多信息，请联系当地的惠普 (HP) 代表或访问www.hp.com/go/hpfinancialservices

了解更多信息

如需了解关于HP ProLiant BL465c G6刀片服务器的更多信息，请联系您当地的惠普 (HP) 代表，或访问：www.hp.com/servers/bl465c

与其他刀片服务器用户、合作伙伴和专家进行交流，敬请访问HP Blade Connect在线社区论坛：www.hp.com/go/bladeconnect



四核皓龙™
处理器

技术以推动业务成效为本

如需了解更多信息，敬请访问：www.hp.com/servers/bl465c

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 本文所含信息如有更改，恕不另行通知。惠普产品与服务的全部保修条款在此类产品和服务附带的保修声明中均已列明。本文中的任何信息均不构成额外的保修条款。惠普对于本文中所包含的技术或编辑错误、遗漏概不负责。

AMD、AMD箭头标识、AMD Opteron及其组合均为Advanced Micro Devices公司的商标。

4AA2-6544CHP 2009年7月

